

株式会社 TBM への独立行政法人中小企業基盤整備機構による 債務保証制度を活用したローンの契約締結について

株式会社みずほ銀行（頭取：加藤 勝彦、以下「みずほ銀行」）は、このたび、株式会社 TBM（代表取締役 CEO：山崎 敦義、以下「TBM」）と総額 20 億円のローン契約を締結しました。

TBM は、「進みたい未来へ、橋を架ける」をミッションとし、炭酸カルシウム（石灰石など）を主原料としたプラスチック・紙の代替品となる新素材「LIMEX」の製造・販売とマテリアルリサイクルを行う資源循環ビジネスを手掛けるスタートアップです。当社製品は既製品と比べて石油由来のプラスチックの使用量や水の利用量、温室効果ガスの削減をすることが可能であり、今後各代替市場での幅広い分野での活用が期待されています。今般のローン契約は、LIMEX のアプリケーション拡大に向けた量産体制の構築を目的としており、サステナビリティへの貢献が期待されています。

なお、本ローンは、独立行政法人中小企業基盤整備機構の「革新的技術研究成果活用事業円滑化債務保証制度」（※）を活用し、日本の将来における新たな産業の創出を目指すベンチャー企業に対して官民が一丸となって支援します。

〈みずほ〉は引き続き、ベンチャー企業への様々な支援を通じて、日本の新たな産業の創出・発展に貢献します。

【本契約の概要】

契 約 締 結 日	2024 年 3 月 18 日
融 資 金 融 機 関	みずほ銀行
融 資 金 額	20 億円
融 資 期 間	運転資金 5 年間、設備投資 8 年間
中小機構の保証割合	借入元本の 50%（10 億円）

※ 経済産業省から革新的技術研究成果活用事業活動計画の認定を受けたディープテック（大規模研究開発型）ベンチャー企業の量産体制整備のための資金等に係る指定金融機関等からの融資に対し、独立行政法人中小企業基盤整備機構が借入元本の 50%の債務保証を行う制度です（保証上限額は 25 億円）。

以 上